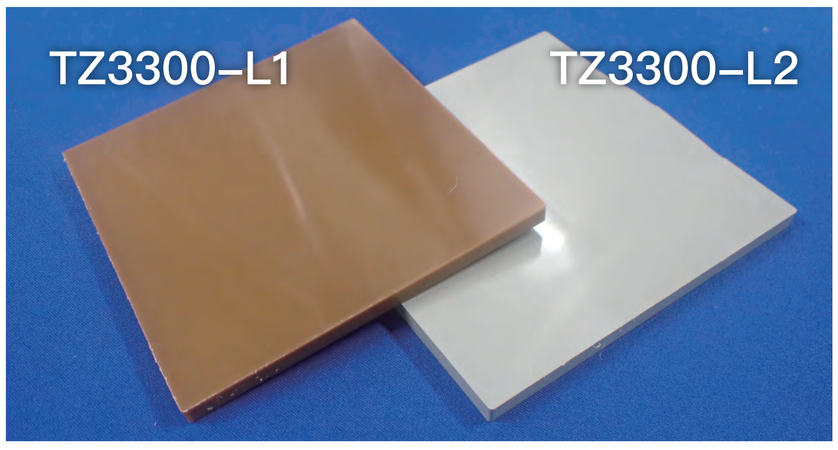
测试插座的低Dk材料 TZ3300-L系列

陶瓷增强聚酰亚胺材料

“用于IC测试的下一代基板：无与伦比的低介电系数”

特 性

- Dk≈2.6 (10GHz) – 业界最低水平之一
- 具备φ100以下精密微孔加工能力
- 具有高温耐受性PI的卓越尺寸稳定性
- 卓越的可加工性：适用于多样化应用的多功能成形
- 具有卓越低吸湿性的PI材料



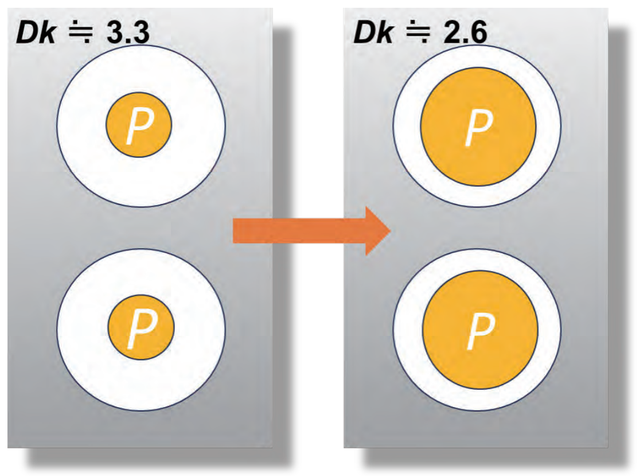
基本物性

材料的各种物性

	条件	单位	L1	L2
抗弯强度	—	MPa	125	124
弯曲模量	—	GPa	2.8	3.2
介电常数(Dk)	10GHz	—	2.67	2.67
介电损耗角正切(Df)	10GHz	—	0.0028	0.0035
CTI	—	V	≧600	550
吸水率	24小时浸泡	%	0.1	0.1

应用实例

- 探针直径的扩大

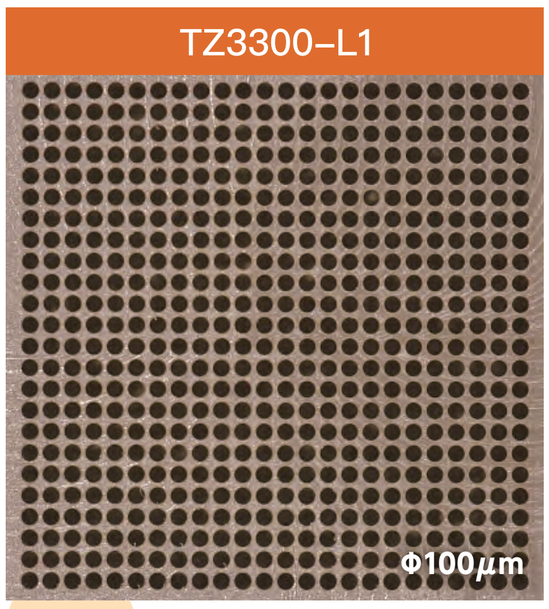


通过低Dk技术
实现探针间干扰最小化

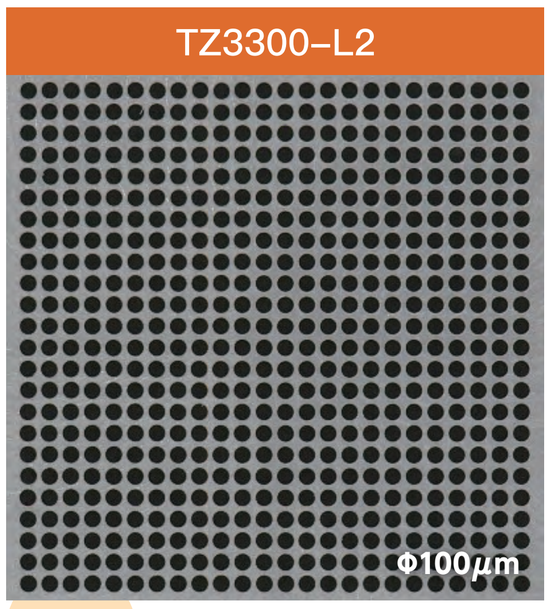
通过扩大探针
实现可靠性提高和成本降低

- 通过高密度孔和探针设计实现小型化

钻孔加工性

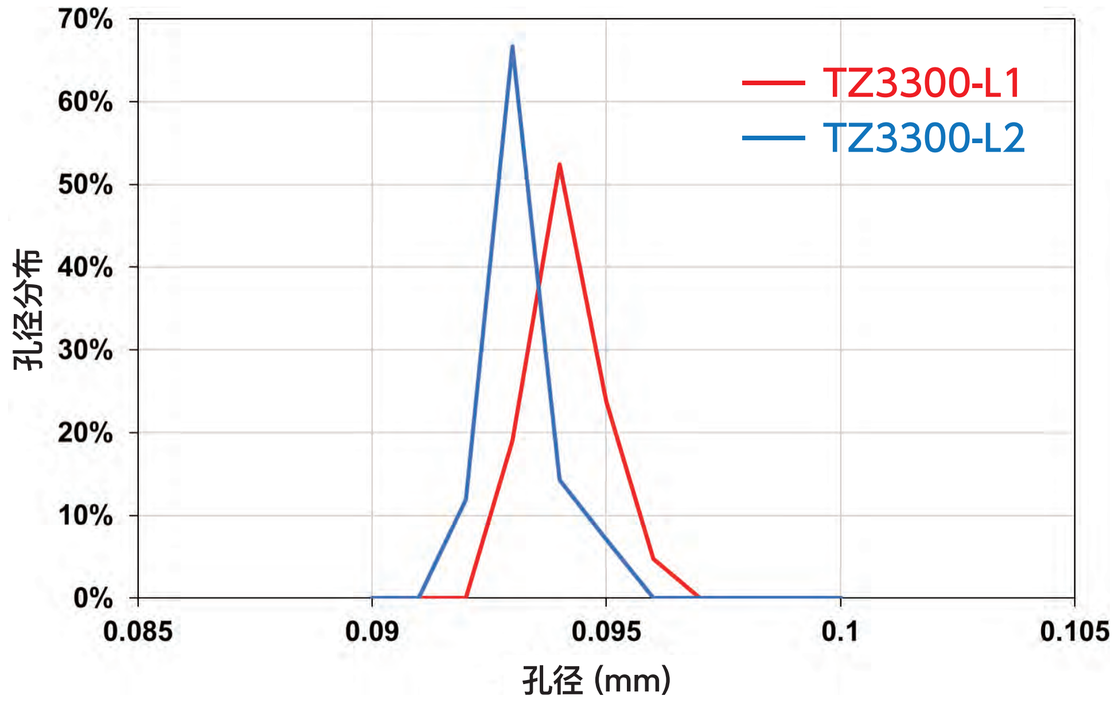


孔间内壁无崩塌



毛刺少, 图案整洁

孔径分布



三菱瓦斯化学株式会社
GEC事业部門 企划开发部
电话 +81-3-3283-4763　邮箱 therplim@mgc.co.jp